

Pressemitteilung

**Deutsche Bauelemente-Distribution startet mit Aufwind ins neue Jahr –  
und mit drohenden Gefahren**

**Deutscher Bauelemente-Distributionsmarkt (gemäß FBDi e.V.) wuchs im  
ersten Quartal um 6,3%, die Aufträge nahmen um 20% zu.**

**Bad Birnbach, 24. Mai 2017** – Der Start ins neue Geschäftsjahr wird die Bauelemente-Distribution in Deutschland freuen. Nach einem eher durchwachsenen 2016 legte der Umsatz der im Fachverband Bauelemente Distribution (FBDi e.V.) gemeldeten Unternehmen in Deutschland im ersten Quartal 2017 um 6,3% auf 907 Millionen Euro zu - ein Rekordergebnis. Noch besser sind die Aussichten für die nächsten Quartale, die Aufträge wuchsen um 20% auf über 1 Milliarde Euro. Die Book-to-Bill-Rate lag bei 1,11.

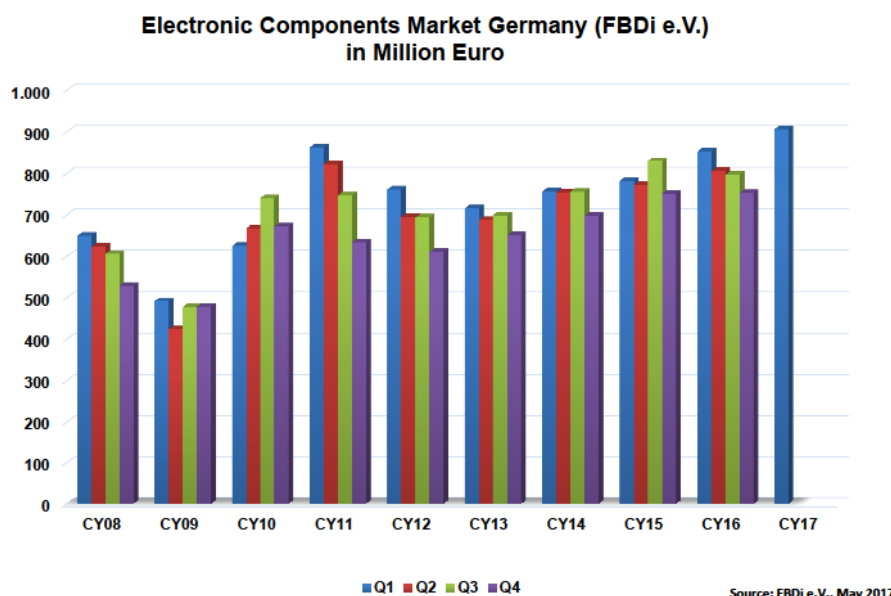
Der Gewinner unter den Produktsegmenten ist die Elektromechanik, die um knapp 13% auf 91 Millionen Euro wuchs, gefolgt von den passiven Bauelementen, die um 7,5% auf 122 Millionen Euro zulegt. Etwas schwächer lief es bei den Halbleitern, die um 5,9% auf 635 Millionen Euro kletterten. Auch die Stromversorgungen stiegen zweistellig, um 12,2% auf 25 Millionen Euro. Weniger gut entwickelten sich Displays und Sensoren, die beide im zweistelligen Bereich sanken. An der Verteilung änderte sich wenig: Halbleiter 70%, Passive 13%, Elektromechanik 10%, Stromversorgungen 3%, der Rest verteilt sich auf die anderen Komponenten und Baugruppen.

FBDi-Vorstandsvorsitzender Georg Steinberger: „Ein guter Start, der sicher durch die gute Auftragslage noch verschönert wird. Insgesamt sieht die Lage für die deutsche High-tech-Industrie sogar noch besser aus, da ein großer Teil der von ihr gesteuerten Elektronikfertigung im günstigeren Osteuropa stattfindet. Das gefühlte Wachstum der Kunden im ersten Quartal ist eher zweistellig.“

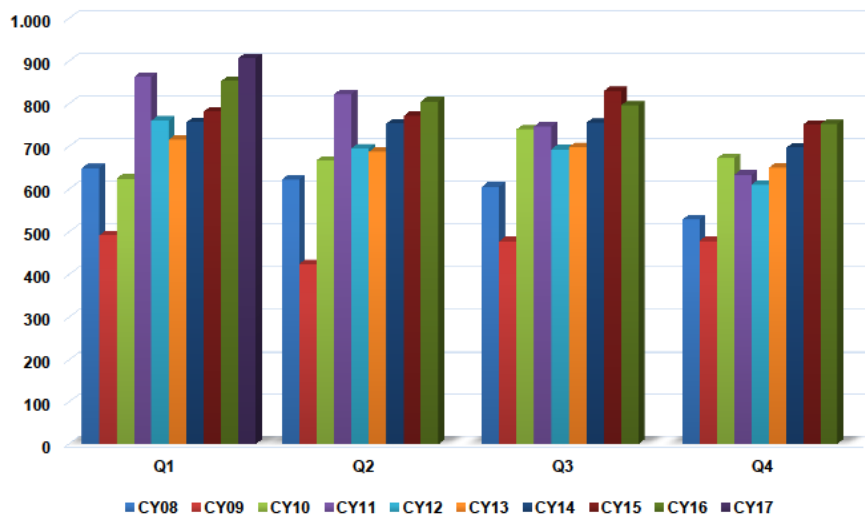
Natürlich gebe es auch weiterhin Risiken, so Steinberger: „Wir vermuten, dass aufgrund der länger werdenden Lieferzeiten in der Halbleiterteilfertigung und der allgemein hohen Fabrikauslastung viele Doppelbuchungen existieren. Zudem wird 2017

weiterhin von Preiserhöhungen durch die Hersteller geprägt werden. Da immer mehr Halbleiter-Komponenten Single-Source-Produkte werden, schränkt das die Auswahl der Kunden und damit das Verhandlungspotential deutlich ein. Viele Hersteller verengen außerdem ihre Vertriebskanäle oder versuchen typische Distributionskunden selber zu bedienen, was nicht zwangsläufig zu mehr Kundenfreundlichkeit und Service führen wird.“

Größere Probleme dürften in 2017 auch die Politik und ihre produktrelevanten Entscheidungen und Direktiven verursachen. Steinberger: „Als wäre der Verwaltungsaufwand durch RoHS, WEEE oder Konfliktminerale nicht schon groß genug, wird die Änderung der Chemikalienverordnung durch EU-Kommission und ECHA (Europäische Chemikalien Agentur) nach Einschätzung des FBDi zu einem kompletten Desaster und einem informationstechnischen Offenbarungseid für die gesamte Elektronik-Industrie, die doch eigentlich nur ein Kollateralschaden der Chemikalienverordnung ist. Die Aufspürung und Administration von Informationen über Hunderte von Substanzen bis in die Bestandteile von Chips und Kondensatoren hinein ist schlicht unmöglich. Auch ein Chemielabor im Logistikzentrum kann das nicht lösen.“



### Electronic Components Market Germany (FBDi e.V.) in Million Euro



Source: FBDi e.V., May 2017

###

#### Über den FBDi e. V. ([www.fbdi.de](http://www.fbdi.de)):

Der Fachverband der Bauelemente Distribution e.V. (FBDi e.V.) seit 2003 eine etablierte Größe in der deutschen Verbandsgemeinschaft und repräsentiert einen Großteil der in Deutschland vertretenen Distributionsunternehmen elektronischer Komponenten.

Neben der informativen Aufbereitung und Weiterentwicklung von Zahlenmaterial und Statistiken zum deutschen Distributionsmarkt für elektronische Bauelemente bildet das Engagement in Arbeitskreisen und die Stellungnahme zu wichtigen Industriethemen (u.a. Ausbildung, Haftung & Recht, Umweltthemen) eine essenzielle Säule der FBDi Verbandsarbeit.

#### Die Mitgliedsunternehmen (Stand Januar 2017):

Acal BFi Germany, Arrow Central Europe, Avnet EMG EMEA (Avnet Abacus, Avnet Silica, EBV, MSC Technologies), Beck Elektronische Bauelemente, Blume Elektronik Distribution, Bürklin Elektronik, CODICO, Conrad Electronic SE, ECOMAL Europe, Endrich Bauelemente, EVE, Farnell, Future Electronics Deutschland, Haug Components Holding, Glyn, Hy-Line Holding, JIT electronic, Kruse Electronic Components, MB Electronic, Memphis Electronic, MEV Elektronik Service, Mouser Electronics, pk components, RS Components, Rutronik Elektronische Bauelemente, Schukat electronic, Distrelec Schuricht, SHC, TTI Europe.

**Fördermitglieder:** Amphenol FCI, elotronics, mewa electronic, TDK Europe.

**Mitglieder-Information:**

Wolfram Ziehfuss  
Mayrweg 5  
84364 Bad Birnbach  
Tel. +49 8563 - 9788 908

[w.ziehfuss@fbdi.de](mailto:w.ziehfuss@fbdi.de)

**Presse-Kontakt:**

Georg Steinberger  
C/o Avnet EMG  
Im Technologiepark 2  
85586 Poing  
Tel. 08121/774-203

[georg.steinberger@avnet.eu](mailto:georg.steinberger@avnet.eu)